

美商泰瑞達攜手筑波科技研討會引發熱議

2022-11-30 筑波科技

筑波科技與美商泰瑞達 Teradyne ETS 於 11 月 23 日舉辦研討會，由於電動車、快充帶動第三代半導體碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)國際市場快速發展趨勢、儲能設備及高效能控制機台，需要更多強韌的運算晶片與電源管理 IC 功率元件，專注為高精準、高穩定度，高速測試、低單位 IC 測試成本與強大工程經驗支持能力是攸關 POWER IC 研發及 OSAT 測試成功的關鍵能力，與會來賓現場與筑波科技專業團隊就相關議題和技術交流熱絡，雙方並針對疫後時代的寬能帶半導體整合趨勢提出前瞻分享。



筑波科技與美商泰瑞達 Teradyne ETS 於 11 月 23 日舉辦研討會。圖/筑波科技提供

本次研討會研討會採現場及線上直播並行，主要聚焦實務分享：

1. Teradyne Device Interface Solution Business Overview, 2. GaN and IGBT Probe Interface Solution Overview, 3. WBG Market Trend and Teradyne Eagle System Introduction Practice、4. ACE Universal for SiC/GaN Wafer MA Test Solutions、5. Brief the Specific Functions for Power IC ATE Machines by HT.

筑波科技與美商泰瑞達 Teradyne 合作，攜手推廣 Eagle Test System (ETS)設備系列。因應測試晶片機台需求逐年成長，Teradyne 提供高質量檢驗、快速精準，降低測試成本、提升產能的 ETS 設備，具有高功率(>3000V)、高電流(>100A)、耐高溫、精準穩定之特色。筑波科技則結合材料分析 MA 與故障瑕疵分析 FA、封裝 FT 測試與設備整合經驗，為客戶開發整合測試解決方案(Total Solution)，並設立 EC 半導體工程中心提供高品質的訓練與服務，強強聯手助力半導體業強化整體競爭力。



就 POWER IC 研發及 OSAT 測試成功的關鍵能力，與會來賓現場與筑波科技專業團隊就相關議題和技術交流熱絡。